

日月光九十九年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 99 年 7 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈九十九年度第二季及上半年獲利報告，本公司九十九年第二季之合併營業收入較九十九年第一季成長 24%，較九十八年同期成長 122%，為新台幣 46,416 百萬元。茲將日月光九十九年度第二季單季及上半年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第二季	99 年度 第一季	98 年度 第二季	99 年度 上半年	98 年度 上半年
營業收入	46,416	37,555	20,881	83,971	34,278
營業毛利	9,916	7,556	4,571	17,472	5,247
營業淨利(淨損)	5,763	4,279	2,543	10,042	1,150
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	5,383	4,073	2,206	9,457	560
所得稅利益(費用)	(611)	(455)	(559)	(1,067)	(509)
少數股權純損(益)	(159)	(223)	27	(382)	57
本期淨利(淨損)	4,613	3,395	1,674	8,008	108
稀釋每股盈餘(元)	0.76	0.57	0.29	1.34	0.02

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第二季	99 年度 第一季	98 年度 第二季	99 年度 上半年	98 年度 上半年
營業收入	31,697	27,423	20,881	59,120	34,278
營業毛利	8,303	6,447	4,571	14,750	5,247
營業淨利(淨損)	5,367	3,818	2,543	9,186	1,150
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	5,176	3,931	2,206	9,108	560
所得稅利益(費用)	(525)	(395)	(559)	(921)	(509)
少數股權純損(益)	(38)	(141)	27	(179)	57
本期淨利(淨損)	4,613	3,395	1,674	8,008	108
稀釋每股盈餘(元)	0.76	0.57	0.29	1.34	0.02

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	46
個人電腦	18
汽車及消費性電子產品	36
其他	0
前十大客戶佔營收比重	43

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	52
歐洲	14
台灣	20
日本	9
亞洲其他地區	5

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	85
Traditional leadframe based	6
Module assembly	5
Others	4
封裝資本支出金額	227 百萬美元
打線機台數	10,705 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	83
晶圓測試	15
前段測試	2
測試資本支出金額	127 百萬美元
測試機台數	1,846 台

環隆電氣之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
微電子構裝技術暨製造服務	22
電腦暨週邊產品	16
通訊產品	32
網路儲存暨伺服器產品	10
工業暨汽車電子產品	20
前十大客戶佔營收比重	78
EMS 資本支出金額	7 百萬美元